

FR30M

高效智能標籤倒裝綁定機

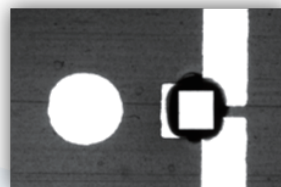
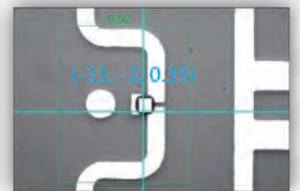
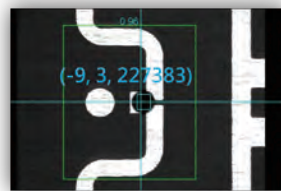
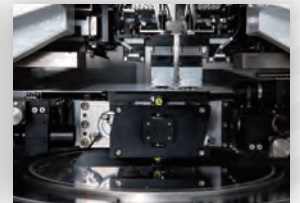


關於FR30M

- 固晶產能效率：30,000枚/小時
- 固晶精度：± 30μm
- 角度精度：± 2°
- 熱壓頭組數：40組
- 熱壓溫度：常溫 ~ 300°C ± 5°C
- 可生產40~340mm幅寬內產品
- 可多道生產、測試、分切、收料

產品特點

- 料帶計算：(軟體)計數料帶長度
- 單噴膠系統、雙複數取放固晶系統
- 即時監控噴膠狀況，含膠量辨識功能
- 固晶前膠量辨識功能
- 即時監控固晶狀況
- 熱壓頭組可作局部程控
- QC拍照-人工檢視
- 測試後膠量檢測



FR30M

高效智能標籤倒裝綁定機

項目	細部項目	規格	備註
主要規格	電源規格	單相, AC220V, 14A / 18A	
	正壓氣壓規格	0.55Mpa	正壓消耗量: 200L/min
	負壓氣壓規格	-90kpa	負壓消耗量: 50L/min
	機台尺寸 (mm · W x D x H)	12000 (L) x 1400 (D) x 2310 (H)	長度尺寸 · 含天線卷帶入料處的作業空間 + 襯紙架放置所需的建議空間; 高度尺寸 · 含三色燈裝置。
	機台總重量 (kg)	7800	設計階段的概估數值
	固晶產能效率	30,000ea/hour	視產品需求而定
	固晶精度 (um · X / Y direction)	±30	
	角度精度 (°)	±2.0	
卷帶規格	卷帶幅寬 (mm)	40 ~ 340 (Max.)	
	收放料帶直徑 (mm)	90 ~ 450	
	天線最小間距 (mm)	15.875 (Min.)	[雙排以上天線卷帶] X-Pitch (拉帶方向): 15.875mm (Min.) Y-Pitch (排數方向): 35.00mm (Min.)
	天線卷帶材質	PET、Paper	
晶片盤規格	晶片尺寸 (mm)	0.3x0.3 ~ 2.0x2.0	
	晶片盤尺寸 (inch)	8 / 12	
	晶片盤型式	STD Metal Frame	
捲帶出料	卷帶容許張力 (Kg)	0.1 ~ 1.0	
噴膠	適用於膠材類型	ACP	
	CCD 移動方式	Programmable control	
固晶	固晶力量 (g)	20 ~ 200	可程式控制
	CCD 移動方式	Programmable control	
晶片平台模組	擴張行程 (mm)	13 (Max.)	
	頂針座型式	單頂針	僅適用於較小的晶粒尺寸。
熱壓固化	熱壓力量 (g)	60 ~ 450	可程式控制
	固化溫度 (°C)	Ambient to 300°C Max.	
	熱壓固化時間 (sec)	可依據膠材特性決定	此為制程參數條件 · 機台僅供可設定不同參數條件的功能需求。
	批次壓合數量 (sets)	40 sets Max.	
	CCD 移動方式	Programmable control	
測試	晶片頻率型式	HF / UHF	測試系統 或 裝置 (包含測試軟體、測試板、Reader 裝置、接頭端子、以及相關連接線材等) · 皆須由客戶自行提供之。
卷帶收料	收料軸	2	
	收料張力 (N)	3 ~ 10	
	分切刀具 (ea)	9 (Max.)	
	分切精度 (mm)	±0.50	

ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.